

報道関係者各位

## 米国 Palomar Technologies Inc. と代理店契約

### ワイヤボンディング装置を販売開始

エレクトロニクス専門商社の丸文株式会社（東京都中央区、社長：堀越毅一、資本金：62 億 1,450 万円、東証 1 部）は、自動ワイヤボンディング装置メーカーの米国 Palomar Technologies Inc.（パロマーテクノロジーズ：以下 Palomar 社）と、日本における販売代理店契約を締結し、1 月より同社の自動ボールボンダなどの販売を開始しましたので、お知らせいたします。

Palomar 社は、オプティカルデバイスや RF モジュールなどの化合物半導体用のボンディングを得意とした自動ワイヤボンディング装置メーカーです。設立当初より化合物半導体市場をターゲットに製品開発を行い、現在では、ボールボンディング装置、ウェッジボンディング装置、ダイボンディング装置、光デバイス用の自動光調芯装置などを製品化しております。これまで同社製品はアメリカ・アジア市場を中心に LED/LD 製造メーカー・研究機関に 300 台以上の納入実績があり、今後は特にオプティカルデバイスの分野で、次世代 DVD（DVD-Blue）用ピックアップ LD や情報通信機器分野のキーパーツになると考えられる MEMS などの市場での採用が見込まれております。

丸文株式会社では半導体製造分野において、これまで前工程における化合物半導体用の製膜装置や後工程における IC 外観検査装置、X 線検査装置、ハンドラー、バーンインシステムなど国内外の製品を販売しております。Palomar 社のワイヤボンディング装置の販売は、初年度 2 億円、3 年後 10 億円の売上を計画しています。

#### <主な製品>

##### 自動ボールボンダ「CBT-6000」（添付写真）

自動ボールボンダ「CBT-6000」は、ボンドヘッドの垂直動作に Palomar 社独自開発の電磁石動作機構（ボイスコイル方式）を採用して高速動作を実現した自動ボールボンダです。また従来、テーブルの動作で制御していた XY 軸移動を、ボンドヘッド自身をエアベアリングで XY 軸に制御することで、高速で広いボンディングエリア（152×304mm）での動作を可能にしました。複数段差のあるスタック IC へのループコントロールボンディング、TO システムへのピンボンディング、ウェハーバンプボンディング、コーナーバンプボンディングなどにも対応できます。

##### 6 軸アライメントエンジンおよび自動光軸調芯システム

光デバイスパッケージへの光ファイバー導入時のファイバー移動調整テーブル（6 軸アライメントエンジン）と、この 6 軸アライメントエンジンに制御ソフトウェア、光学計測器、エポキシ接着機構、画像認識機能などを組み合わせてシステム化した自動光軸調芯システムです。6 軸アライメントエンジンはナノメートルレベルの高分解能（10nm）を実現し、あらゆる角度に駆動させることが可能です。

## ＜第 20 回エレクトロテスト・ジャパン出展について＞

丸文株式会社では、2003 年 1 月 22 日（水）から東京ビッグサイトで開催される「第 20 回エレクトロテスト・ジャパン」に、Palomar 社製品をはじめ X 線検査装置などを出展（ブース：東 1 ホール No. 25-6）いたします。招待券をご希望される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

## ＜Palomar Technologies Inc. の概要＞

代表者：Gary E. Gist (Chairman)

本社：米国サンディエゴ

設立：1995 年

従業員数：150 人

売上高：約 45 百万 US ドル（2001 年/アジア地区）

事業内容：オプティカルデバイスや RF モジュールなどの化合物半導体用のボンディングを得意とした自動ワイヤボンディング装置メーカー。設立当初より化合物半導体市場をターゲットに製品開発を行い、現在では、ボールボンディング装置、ウェッジボンディング装置、ダイボンディング装置、光デバイス用の自動光調芯装置などを製品化している。アメリカ・アジア市場を中心に LED/LD 製造メーカー・研究機関に 300 台以上の納入実績を持つ。

Palomar 社の詳細については、[www.palomartechnologies.com](http://www.palomartechnologies.com) をご覧ください。

## ＜丸文株式会社の概要＞

代表者：堀越 毅一

本社：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立：1947 年

資本金：62 億 1,450 万円

従業員：983 名（2002 年 4 月 1 日現在）

売上高：1,381 億円（2002 年 3 月期連結）

事業内容：集積回路を中心とした半導体、電子応用機器など、国内外の最先端エレクトロニクス製品を販売。半導体製造分野に置いてはこれまで、前工程における化合物半導体用の製膜装置やレーザ製膜装置、後工程における IC 外観検査装置、X 線検査装置、ハンドラー、バーンインシステムなど国内外の製品を販売、この分野を含めた産業機器部門で 2001 年度 130 億円の売上実績を持つ。東京証券取引所市場第 1 部に上場。（コード番号：7537）

丸文株式会社の詳細については、[www.marubun.co.jp](http://www.marubun.co.jp) をご覧ください。

## このニュースリリースに関するお問い合わせ先

丸文株式会社 広報室

担当：喜多康人（キタ ヤスヒト）

〒103-8577 東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

TEL：03-3639-9803

FAX：03-5644-7693

E-mail：[koho@marubun.co.jp](mailto:koho@marubun.co.jp)

## この製品に関するお問い合わせ先

丸文株式会社 産業機器第部

担当：南部信夫（ナンブ ノブオ）

〒103-8577 東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

TEL：03-3639-9823

FAX：03-3639-2358

E-mail：[nanbu@marubun.co.jp](mailto:nanbu@marubun.co.jp)



米国Palomar Technologies Inc.製  
自動ボールボンダ「CBT-6000」